附件1：年会报告内容

中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会

第三十一届年会报告内容

1、【报告：海关政策解读】

2、【报告：宏观经济形势展望】

3、【报告：锡市场形势分析与趋势展望】

4、【报告：IC封装用与锡有关材料与技术探讨】

5、【报告：功率器件封装用高可靠焊料的技术现状和发展趋势】

6、【报告：板级焊接的可靠性评估】

7、【报告：人工智能时代对锡焊料的需求探讨】

8、【报告：企业海外市场的开拓之路】

9、【报告：电子锡焊料标准体系及案例分析】

（注：最终报告顺序以会议日程安排为准）